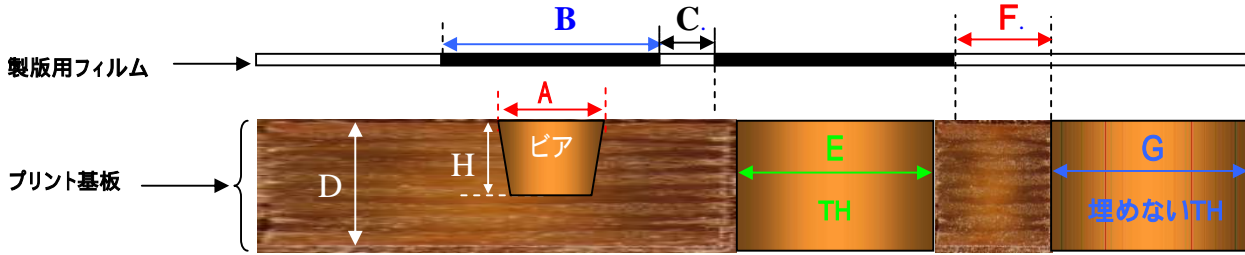


# 有底ビアプラグ加工仕様

(株)野田スクリーン  
登録日 2012年05月11日



1)加工基本仕様 (下記から1点でも外れるものはツール手配前に事前打合せ要)		
項目	加工仕様	注記
ワークサイズ	255 ~ 515 x 615 mm	範囲外は事前検討が必要
板厚 (D)	0.12 D 6.50 mm	基材厚の最薄は0.10mmまで
-1 ビアTop径 (A)	0.05 A 0.30 mm	樹脂系インクに適用
アスペクト比 (H÷A)	1 以下	
-2 ビアTop径 (A)	0.08 A 0.15 mm	金属系インクに適用
アスペクト比 (H÷A)	1 以下	
TH径 (E)	0.10 E 0.80 mm	
フィルムドット接近最小距離 (C)	0.05mm以上	0.05mm未満は事前検討が必要
TH加工エリア	基板端面から10mm以上離れること	充填するTH対象
穴埋め印刷固定用ガイド穴	2.00 ガイド穴 3.50mm	弊社在庫にあるガイドピンサイズ
ハーフェッチ	15μ 仕上がり導体厚狙い値	基礎銅箔エッチング品は除く 最小エッチング量 4μm

2)加工に際してその他注意事項		
項目	注意事項	注記
表面導体厚切削量	標準3 ~ 5μm	標準フローでの参考値
充填しないTH径 (G) 1	1.00mm以下	ハフカス詰まり発生リスク有り
充填しないTH径 (G) 2	2.00mm以上	エッジ切れリスク有り
充填しないTHと充填するTH製版用フィルムエッジ間距離 (F)	0.15mm以上	満たない場合、インクのタレ込みのリスク有り アスペクト比12以上は事前検討が必要
インク	UV硬化インク(DC5-4)は不可	
表面状態	表面粗化処理は不可	処理有りの場合粗化面除去が必要

3)NSツール手配と必要情報及びデータ支給について	
項目	記載事項
新規製品情報通知書(別紙)	ワークサイズやインク種がツール準備に必要となります
フィルム作製 (フィルム顧客支給の場合は4)へ 別紙参照【特殊印刷品のツール作製】	穴埋め用データ(NCドリルデータ)を支給願います 充填するTHやしないTH、ガイド穴などでの特別指示は、ツール番号表にてご連絡下さい 同じツール番号で充填しないTHがある場合、充填するTHのみのデータをご準備下さい 両面印刷の場合、ガイド穴は充填ビアより外側に3点必要です。
スクリーン版作製	上記支給フィルムまたはNS手配フィルムにて作成
治具板作製	NCドリルデータを支給願います (で支給いただいた場合は不要です)
穴埋め用データ支給日(リードタイム)	加工開始予定日の前日朝までに支給願います。 - の作成に1日必要

4)製版用フィルム支給について	
項目	記載事項
フィルム膜面	支給して頂くデータと同様の面視で充填するTHのみ黒点・膜上にて出力願います
フィルム点径	(下記表5)に記載された基準値で出力願います
フィルム寸法補正	X、Y 0%にて支給願います (寸法差が著しい場合は、リピート時別途相談になります)

5)顧客支給の製版用フィルム点径設定 (単位: mm)			
ビア径(A)	0.05 A < 0.15	0.15 A < 0.25	0.30 A
フィルム点径(B)	0.4	A+0.25	事前確認要

充填する貫通THの製版用フィルム点径設定は、フラットプラグ加工仕様を参照

6)その他事項	
項目	記載事項
仕様外加工製品	有底プラグ加工仕様から外れる製品加工については、個別に調整させて頂きます。
新規製品情報通知書	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
NCデータ	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
製版用支給フィルム	製造部 生産管理課宛 に発送をお願いします。